公司代码:688126　　公司简称:沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月10日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》,2022年度利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李铁	王艳
办公地址	中国上海自由贸易试验区临港新片区云水路1000号	中国上海自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
电话	021-52889038	021-52889038
电子信箱	pr@sh-natg.com	pr@sh-natg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

半导体硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料,是半导体产业链基础性的一环。公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一,将扩大生产规模、丰富产品结构、提高市场占有率作为公司业务发展的重要战略任务。

公司目前产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片及外延片、SOI硅片、压电薄膜衬底材料等,产品广泛应用于存储芯片、图像处理芯片、通用处理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模拟芯片、分立器件等领域。

公司现拥有众多国内外知名客户,包括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Tower jazz等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏力、华力微电子、华润微等国内所有主要芯片制造企业,客户遍布北美、欧洲、中国、亚洲其他国家或地区。

截止本报告期末,子公司上海新昇300mm半导体硅片已全面完成30万片/月的产能建设,正在实施的30-60万片/月新增30万片/月300mm半导体硅片产能建设项目将在2023年内逐步投产,最终达到60万片/月的300mm硅片产能;子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下抛光片、外延片合计产能超过50万片/月;子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下SOI硅片合计产能超过6.5万片/月。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片实现收入和利润。

2、采购模式

为保证公司产品的质量和性能,公司制定了严格的供应商选择和审核制度。达到经营资质、研发和设计能力、技术水平、质量管控能力、生产能力、产品价格、交货周期及付款周期等众多标准要求的供应商,才可以被考虑纳入公司合格供应商名录,并定期审核。目前,公司已经与全球众多供应商建立了长期、稳定的合作关系。

3、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式,大部分产品按订单批量生产,同时进行少量备货式生产。在生产方面,公司建立了生产管理制度,对生产过程中的各个因素进行控制,合理安排生产,协调各项生产活动,确保产品质量及交付满足规定的要求和客户的需求。在自主生产为主的同时,公司结合市场情况和自身产能利用情况,在部分非关键性技术生产环节适当配以外协加工进行辅助,以最大化满足市场需求。

4、销售模式

报告期内,公司全部产品均通过直销模式销售。由于半导体硅片的行业壁垒较高,生产企业和主要下游客户较为集中,公司通常采取主动开发潜在客户并与客户直接谈判的方式获取订单。同时,公司也通过少量代理商协助开展中小客户的接洽工作。

5、研发模式

公司是“产、学、研一体化”研发模式的践行者,未来将继续实行这一研发模式,继续与教学科研机构紧密合作,在公司改进自身技术的同时,促进中国半导体硅片行业的科学技术进步,提升中国半导体硅片的科研水平。公司将进一步加大核心产品相关技术的研发投入,在最前沿的单晶生长、切割、研磨、抛光、外延与SOI技术方面继续追赶国际先进水平。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段

长期以来,半导体行业呈现周期性波动上涨的趋势。根据SEMI统计,2016年至2022年间,全球半导体硅片(不含SOI)销售额从72.09亿美元,上升至近138亿美元,年均复合增长率达11.47%。2016年至2022年间,中国大陆半导体硅片销售额从5亿美元上升至19亿美元,年均复合增长率高达25.06%%,远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率。2016年至2022年间,全球SOI硅片市场销售额从4.41亿美元增长至16.55亿美元,年均复合增长率24.66%。

根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)2023年3月发布的数据,2022年全球半导体市场规模为5,741亿美元,同比增长3.27%,再创历史新高。在全球宏观经济环境相对疲软的情况下,受新能源汽车、5G移动通信、人工智能、大数据等终端市场的驱动,半导体行业仍然保持了稳定增长的势头。然而,自2022年下半年以来,个人电脑、智能手机等消费类电子产品各终端市场出货量下滑,下游库存攀升,并逐步向产业纵深蔓延。公司所处半导体硅片细分行业处于半导体产业链上游,经营业绩与整体半导体行业所呈现的景气度密切相关。SEMI数据显示,2022年全球半导体硅片(不含SOI)出货面积合计14,713百万平方英寸,同比增长3.87%,与全球半导体市场规模增长趋势一致,然而,2022年第四季度,全球半导体硅片出货面积为3,589百万平方英寸,较第三季度下降4.06%,半导体硅片行业同样进入周期性库存调整阶段。

虽然受全球经济环境及行业周期性波动影响,目前,半导体硅片行业仍处于产能扩张阶段,海外主要半导体硅片生产企业的新增产能将陆续于2024年至2025年投入量产。根据全球排名第二的半导体硅片企业日本胜高预计,2023年全球300mm半导体硅片市场的供应紧张局面将在一定程度得到缓解,进入相对宽松的平衡供需关系,但随着下游芯片制造企业的产能扩充和逐步投产,在2024-2026年将再次出现供不应求的紧张局面,半导体硅片市场,特别是300mm半导体硅片市场长期仍将处于持续增长的市场环境。

(2)行业发展的基本特点

半导体行业整体上呈周期性波动和螺旋式上升的趋势,半导体硅片行业的市场波动基本同步于整个半导体行业的波动周期。2021年,虽然芯片行业整体仍处于周期性上行阶段,但半导体产业的发展依然有其周期性。全球半导体产业已经进入“后摩尔定律时代”,在市场严重供不应求的情形下,面对新的挑战,在产能扩充的同时进行技术升级,是各个产业链环节上的企业抓住市场时机、探索相应机会的基础。

据SEMI统计,截止2022年底,全球26条芯片制造生产线投入量产,并有35条新增高产能芯片制造产线进入建设期。尽管目前国际主要半导体硅片企业均已启动扩产计划,但其预计产能长期来看仍无法完全满足全球范围内芯片制造企业对半导体硅片的增量需求,国内半导体硅片行业将迎来快速发展期。

(3)主要技术门槛

半导体硅片作为芯片制造的关键原材料,技术门槛较高,属于技术密集、人才密集行业。产业链下游的半导体芯片制造通常采用不同工艺制程完成,不同的芯片制程工艺技术节点,对应于不同的特征尺寸和最小线宽,对半导体硅片晶体原生缺陷和洁净质控水平、硅片表面和边缘平整度、翘曲度、厚度均匀性等提出了不同的技术指标要求。下游芯片制程的技术节点越先进,特征尺寸越小,对应的硅片上述指标控制越严格,不同的技术节点对应的指标控制参数甚至会相差几个数量级。

公司掌握了半导体硅片生产的多项核心技术,包括但不限于300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片相关的直拉单晶生长、磁场直拉单晶生长、热场模拟和设计、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐蚀、双面研磨、边缘研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光、硅片清洗、外延等技术以及SOI制备技术,全面突破了300mm近完美单晶生长、超平坦抛光工艺以及极限表征等关键技术瓶颈,并建立了具有国际化水平的300mm硅材料极限表征体系,强有力支撑了研发工作的快速迭代,保障了公司半导体硅片产品质量与国际领先水平的同步提升。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

半导体硅片行业是寡头垄断的行业,长期以来均被全球前五大硅片厂商垄断,包括日本的信越化学和SUMCO、中国台湾环球晶圆、德国Siltronic和韩国SK Siltron,上述五家企业合计占据近90%市场份额。

公司以全球前五大为目标,业务发展迅速、收入规模不断扩大,在全球半导体硅片市场份额持续提升。近三年(2020-2022年)来,公司营业收入分别约为18.1亿元、24.67亿元和36亿元。全球市场份额分别约为2.3%、2.7%和3.5%,市场占有率逐步提高。

公司作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一,将进一步扩大规模、丰富产品结构、持续提高市场占有率作为公司业务的重要战略任务。报告期内,公司各子公司分别启动了符合公司发展目标的扩产建设项目,以实现300mm及200mm半导体硅片产能的扩充和300mm高端硅基材料国内技术空白的填补,在保持国内领先地位的基础上,把握当前市场机遇,快速提升国际综合竞争力。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路制程亦称为工艺节点或特征线宽,因晶体管栅极宽度的尺寸,用来衡量半导体芯片制造的工艺水准。随着半导体制程的不断缩小,芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度不断降低。对应在半导体硅片的制造过程中,需要更加严格地把控硅片表面微粗糙度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、表面颗粒尺寸和数量等技术指标,这些参数将直接影响半导体产品的成品率和性能。

一般来讲,300mm芯片制造对应的是90nm及以下的工艺制程,包括常见的90nm、65nm、55nm、45nm、28nm、16/14nm、10/7nm、5/3nm等;200mm芯片制造对应的是90nm以上的工艺制程,包括常见的0.13μm、0.15μm、0.18μm、0.25μm等。

依照摩尔定律,集成电路朝着面积更小、速度更快、价格更便宜、能耗更低的方向前进。与此同时,大量应用如射频器件、传感器、功率器件等,考虑到实际技术需求和成本、可靠性等,可以在28nm及以上技术节点的成熟工艺生产线上制造,无需遵循摩尔定律。因此,28nm以上的成熟技术节点硅片,仍存在大量需求。

总的来说,未来随着5G/6G、人工智能、云计算、物联网、智能汽车等多种技术的发展和应用的拓展,半导体(硅片)一方面仍然会沿着摩尔定律向更先进的5nm、3nm、2nm制程前进,另一方面28nm以上的成熟制程仍将在很长一段时间内继续发展。两者共同促进智能社会、智慧生活的到来。

除此之外,受新能源汽车市场驱动,面向汽车电子应用的各类车规级芯片需求日益增长,随着相关芯片制造工艺的技术升级,对相应的半导体硅片产品提出了新的要求,各类用于车规级驱动芯片、电源管理芯片、IGBT、功率器件、图像传感器、MCU等的特殊规格300mm硅片产品、200mm硅片产品以及SOI产品都将迎来新的市场机会,同时也对半导体硅片企业的技术研发能力、产品组合布局窗口以及一站式服务能力提出了更高要求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,546,260,641.08	1,625,671,274.87	56.63	1,449,856.73
归属于上市公司股东的净资产	1,429,099,875.48	1,042,193,241.83	37.12	944,304
营业收入	360,036,096.74	246,683,224.14	46.06	181,127.78
归属于上市公司股东的净利润	32,503,170.42	14,611,236.76	122.45	8,707.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,524.88	-13,163.78	不适用	-28,064.76
经营活动产生的现金流量净额	45,881,557.771	30,748,958.21	49.21	37,654.6
加权平均净资产收益率(%)	2.29	1.47	增加0.82个百分点	1.14
基本每股收益(元/股)	0.121	0.069	106.06	0.038
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.068	106.17	0.037
研发投入占营业收入的比例(%)	5.87	5.10	增加0.77个百分点	7.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	78,644.23	85,989.84	94,983.28	100,418.76
归属于上市公司股东的净利润	-1,515.22	7,020.91	7,088.94	19,908.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-328.06	2,840.22	6,391.30	2,621.41
经营活动产生的现金流量净额	16,334.82	2,101.26	48,369.89	-20,914.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	62,470
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,079
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海国盛(集团)有限公司	0	567,000,000	20.76	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	567,000,000	20.76	567,000,000	567,000,000	无	0	国有法人
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	-1,404,958	158,373,296	5.80	0	0	无		国有法人
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,600,000	137,800,000	5.04	0	0	无		其他
上海新微科技集团有限公司	-2,157,144	136,582,856	5.00	0	0	无	0	国有法人
上海新阳半导体材料股份有限公司	-31,527,090	108,126,410	3.96	0	0	冻结	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-国泰中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	17,399,364	72,900,000	2.67	0	0	无		其他
华泰投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	72,011,521	72,011,521	2.64	0	0	无		其他
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	45,182,670	60,088,989	2.20	0	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	59,298,268	59,298,268	2.17	0	0	无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　　未知关联情况

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　　无

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海硅产业集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	21沪硅产业MTN001	102102271	2024-11-10	500,000,000	3.58

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海硅产业集团股份有限公司2021年度第一期中期票据	2022年度付息1790万元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	23.24	36.46	-34.44
扣除非经常性损益后净利润	11,524.88	-13,163.78	不适用
EBITDA全部债务比	0.39	0.23	69.57
利息保障倍数	5.66	3.21	76.40

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入为360,036.10万元,较上年同期增长45.95%,主要系公司下游半导体产品需求旺盛,且公司产能进一步释放,特别是公司300mm半导体硅片产品的销量增长显著所致。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2023-011

上海硅产业集团股份有限公司 关于首次实现盈利暨取消股票简称标识U的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 自上市公司A股股票简称后增加的特殊标识“U”取消,A 股股票代码688126保持不变,取消股票特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

●取消股票特别标识U的起始日期:2023年4月12日。

一、取消股票特别标识U的情况说明

上海硅产业集团股份有限公司于2020年4月20日在上海证券交易所科创板上市,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股票及存托凭证交易事项的通知》等有关规定,公司2019年度归属于母公司股东的净利润为-8,991.45万元,扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-23,737.45万元,属于上市时未盈利企业,因此自公司上市之日起A股股票特别标识为“沪硅产业-U”。

公司2022年度财务报告已经审计,公司2022年度归属于母公司股东的净利润为32,503.17万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,524.88万元;公司2022年年度报告已经董事会审议通过,并于2023年4月11日披露。公司2022年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股股票将于2023年4月12日取消特别标识U,A股票代码688126保持不变。

二、其他事项的说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》,公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2023-013

上海硅产业集团股份有限公司 关于2022年年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营成果,经公司及下属子公司对各项金融资产、存货、预付款项和长期资产等进行全面充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算,公司2022年计提的各项减值损失总额约为4,427.11万元左右。具体情况如下表所示:

单位:人民币万元

资产名称	账面金额	资产可收回金额	资产可收回金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	本期计提金额	计提原因
存货	85,643.28	82,311.18	按存货成本与可变现净值孰低提取存货跌价准备	按照企业会计准则的规定,期末按照存货的可变现净值计算应计提的存货跌价准备	3,378.07	单独测算
应收账款	69,259.84	68,608.05	将应收款项分为:单项计提预期信用损失和按相合计提预期信用损失,并根据整个存续期间内预期信用损失的预计信用损失率计提减值损失。	按照企业会计准则的规定更新计算截至期末的预期信用损失。	238.57	根据企业准则进行预期信用损失的测算
其他应收款	5,102.83	4,451.72	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。	按照企业会计准则的规定更新计算截至期末的预期信用损失。	651.11	根据企业准则进行预期信用损失的测算
固定资产	153,173.35	153,173.35	固定资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。	按照企业会计准则的规定,对于出现减值迹象的固定资产,按照其可回收金额计提减值准备	88.97	单独测算
在建工程	207,828.05	207,828.05	在建工程的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。	按照企业会计准则的规定,对于出现减值迹象的在建工程,按照其可回收金额计提减值准备	74.43	单独测算
预付款项	11,247.05	11,110.34	预付款项的可收回金额为公司预计能收入公司的经济利益,即预计能收到的货物。对于存在很可能无法收到货物风险的预付款项,公司对应计提资产减值损失。		-4.04	
合计	932,254.40	927,482.69			4,427.11	

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对2022年12月31日的存货项目进行减值测试,并计提存货跌价准备约3,378.07万元,主要是针对生产过程中产生的部分指标未达到标准的硅片产品计提的减值。

2. 坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试,2022年公司需计提的应收款项信用减值损失和其他应收款信用减值损失约889.68万元。

3. 固定资产和在建工程

公司对于不能满足预计使用目的的设备和安装中设备,考虑其预计可收回金额后,计提减值损失约163.40万元,并进行处置。

4. 预付款项

公司对于出现减值迹象的预付账款,主要为存在很可能无法收到货物风险的预付款项,公司按照其可回收金额计提减值准备,经测试,2022年公司需冲回的预付款项减值损失为4.04万元。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2023-015

上海硅产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过330,000万元(包含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,海通证券股份有限公司亦出具了明确的核查意见。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金存放情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3930号),公司于2022年2月向特定对象发行股票240,038,399股,每股发行价20.83元人民币,募集资金总额为人民币4,999,999,851.17元,扣除发行费用人民币53,814,364.71元(不含增值税)后,实际募集资金净额(下称“募资净额”)为人民币4,946,185,486.46元。上述募资资金已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具普华永道中天验字(2022)第0162号《验资报告》予以确认。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年2月26日、2022年5月14日、2022年6月11日、2022年7月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

二、本次募集资金投资项目情况

单位:万元

序号	募集资金项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金总额	调整后拟使用募集资金总额
1	集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目	460,351.20	150,000.00	150,000.00
2	300mm高端硅基材料研发中试项目	214,420.80	200,000.00	200,000.00
3	补充流动资金	150,000.00	150,000.00	144,618.56
合计		824,772.00	500,000.00	494,618.56

三、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项再以募集资金等额置换的基本情况

由于“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”涉及的设备交期较长且多数为海外供应商,部分设备由本项目的原实施主体上海新昇提前向供应商下订单并约定结算设备款项的相关事宜,2022年6月,经公司2022年第三次临时股东大会决议通过,该项目募投项目实施主体变更为上海新昇的控股子公司新昇晶科。具体情况详见公司于2022年5月26日和2022年6月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海硅产业集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告》和《上海硅产业集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》。

由于前述设备供应商多数均为海外供应商,在交易过程中具有较强的主导性,鉴于上海新昇已与其下订单并约定了款项结算事宜,供应商较难接受变更原有约定。为保障设备采购的及时性与连续性,顺利推动募投项目按计划开展,经与供应商协商一致,新昇晶科与上海新昇以及供应商签订协议并约定新昇晶科向供应商采购的设备款项仍委托母公司上海新昇代为履行付款义务。因此,上海新昇拟使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后,再由新昇晶科拟使用募集资金对上述款项做等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见,保荐机构出具了明确的核查意见,上述议案无须提交公司股东大会审议。

五、监事会、独立董事和保荐机构的意见

(一)监事会意见

监事会认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的事项,履行了必要的审批程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和广大投资者的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,我们同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的事项无异议。

六、上网公告附件

(一)独立董事关于公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见

(二)海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的核查意见

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年4月11日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2023-017

上海硅产业集团股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“普华永道中天”)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日,普华永道中天合伙人数为280人,注册会计师人数为1639人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021年度)的收入总额为人民币68.25亿元,审计业务收入为人民币63.70亿元,证券业务收入为人民币31.81亿元。

普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共53家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:赵波,注册会计师协会执业会员,2000年起成为注册会计师,1998年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为公司提供审计服务,1998年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

质量复核合伙人:段永强,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2000年起成为注册会计师,1997年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为公司提供审计服务,1997年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:孙吾伊,注册会计师协会执业会员,2016年起成为注册会计师, 2009年起开始从事上市公司审计,2021年起为公司提供审计服务,2009年起开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核3家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人段永强先生及签字注册会计师孙吾伊先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构,普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师赵波先生、质量复核合伙人段永强先生及签字注册会计师孙吾伊先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了解,认为:在为公司提供2022年度审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,其出具的意见客观公正,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。因此,同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二)公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见,并在董事会上发表明确的独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(三)2023年4月10日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据2023年公司实际业